

AL6200

芯片检测分选机

Version 1.0



产品描述

1. 产品特点及优势

- 1) 具备自动扩膜功能，来料 wafer 未经扩膜也能正常生产；
- 2) 支持上料二维码/条形码扫码，记录来料信息，包括 Wafer ID，卷带 ID。读取异常时可以手动输入，对于无二维码的卷带 tape reel，能自动编号并记录；
- 3) 支持视觉获取 mapping 信息，软件实现数据 MAP 功能；
- 4) 上料系统可以根据要求角度旋转 wafer，最大 360°；
- 5) 支持 tape 宽度 8mm 到 24mm 手动调节，常用 tape 宽度为 12mm；
- 6) 下料支持 8 通道 tape reel，支持 Waffle Pack 扩展；
- 7) UPH 能力 \geq 2K（具体指标视产品工艺与检测要求）；
- 8) 支持芯片六面外观检查，最高支持 10 μ m 检测精度；
- 9) 软件支持单芯片追溯及数据上传，支持 MES 对接；
- 10) 软件支持三级权限管理和多账号管理。

2. 系统功能

参数	指标
适用产品	SiC、IGBT 芯片
晶圆尺寸	6寸、8寸
AOI 功能	外观六面检
来料方式	Frame Ring
出料方式	Tape reel与Tray盘
编带密封方式	热封
氮气保护	>0.6 MPa接入
设备功率	4.5 kW
外形尺寸 (mm)	2885 × 2100 × 1850
SECS/GEM协议	支持

3. 通用指标和软件

参数	指标
工作温度	15-30 °C
存储温度	-10-50 °C
工作湿度	40-70%
存储湿度	<90%
工作海拔	0-2 km
供电功率	200-240 VAC, 30 A, 50 Hz
供气压力	>0.6 Mpa

软件系统	VisualStudio2019
软件语言环境	C# (.Net Frame Work 4.7.2)
软件功能	测试计划编辑, 测试条件和参数Spec设置, 芯片描述, MES接口, 测试数据管理和分析, 校准维护, 故障诊断

4. 技术指标

参数	指标
晶圆上料方式	铁环&子母环
芯片规格(mm)	最大尺寸8*8*0.3, 最小尺寸2.5*2.5*0.18
编带规格(mm)	兼容7" 到13" reel 的尺寸, tape 宽度8 mm到24 mm
表面检测	芯片表面异物、裂纹、划痕、崩缺 Defect 10 μ m
侧边检测	芯片侧边尺寸、裂纹, 崩缺, 异物 Min Defect 20 μ m
下料参数	8通道Tape reel, 可扩展4寸Waffle Pack(可选)
烫封后拉力	≥ 20 g

5. 采购信息

AL6200	芯片检测分选机
选件信息	
吸嘴	根据客户芯片尺寸定制吸嘴
附件	
系统操作说明书、系统软件说明书、系统维护说明书、出厂验证报告、易损件清单	

联系我们

邮箱

sales@semight.com

地址

苏州高新区湘江路 1508 号

官网

更多信息请访问 www.semight.com

*本文中的产品指标和说明可不经通知而更新